

MW-G-VSP

- 低粗度銅箔であるMW-G-VSPは優れた絶縁特性と良好なエッチング特性を実現可能にする、環境に配慮した銅箔です。
MW-G-VSP foil with very low profile to have excellent insulation result and good etchability, and comply with environment regulation.
- MW-G-VSPは高速伝送基板に適した材料です。
Very low profile of MW-G-VSP makes it an excellent material to apply to high speed transmission board.

用途/Application

- ・高速伝送配線板
/HSD (High speed digital)

構成/Composition



生産拠点/Production Site

- ・台灣 / Taiwan

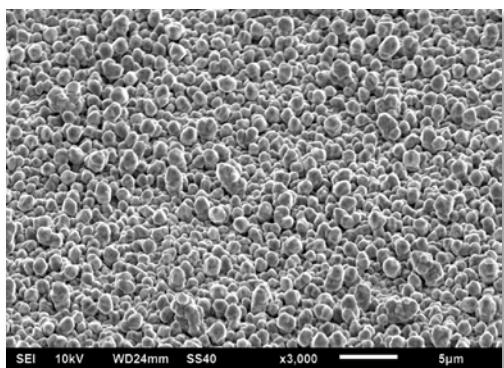
代表的特性値/Representative data

	μ m	Rz (μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)
MW-G-VSP	18	2.5	350	8	1.0
	35	2.5	350	16	1.3
	70	2.5	350	19	1.5

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。

This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 / resist side

